



各 位

平成 29 年 10 月 24 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 和 正
(コード番号 6855 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

子会社の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会で、下記のとおり、シンガポールに子会社を設立することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設立の目的

当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、スマートフォンの高機能化や、データセンター向け需要の拡大等に牽引され、半導体メーカーによる技術革新や生産能力の強化が継続される等、引き続き堅調な成長が予想されます。

当社グループといたしましては、グローバルな事業展開を行うなか、シンガポールをはじめとした東南アジアにおいて、半導体の生産拡大によるプローブカード需要の増加が予想されることを踏まえ、新たにシンガポールへ現地法人を設立し、海外事業の強化を図ります。

2. 子会社の概要

(1) 名 称	JEM Asia Pte. Ltd. (仮称)
(2) 所 在 地	未定 (シンガポール国内)
(3) 代表者の役職・氏名	未定
(4) 事 業 内 容	半導体検査用部品 (プローブカード) の販売及びメンテナンス
(5) 資 本 金	未定
(6) 設 立 年 月 日	未定
(7) 出 資 比 率	当社 100%

3. 今後の見通し

平成 30 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上